

早稲田大学各務記念材料技術研究所オープンセミナー
「次世代スマートフォン向けの圧電材料および弾性波デバイスの進展」

主催：早稲田大学 各務記念材料技術研究所

協賛：調整中

テーマ：「次世代スマートフォン向けの圧電材料および弾性波デバイスの進展」

近年、MEMS（微小電気機械システム）の中でも、超高周波域の RF-MEMS は、5G スマートフォンに多数搭載されていることから、急速な市場拡大を見せています。RF-MEMS のほとんどは弾性波を用いた圧電材料により構成されており、新しい窒化物強誘電体材料や単結晶薄片化貼り付け技術、エピタキシャル薄膜など、最先端の材料技術が次々と事業化、スマートフォンに搭載されています。本セミナーでは、新進気鋭の若手研究者を中心にお招きし、次世代スマートフォン向けの圧電材料および弾性波デバイスについて、ご講演頂きます。

会期	2021 年 12 月 8 日（水） 13：00～17：00		
場所	オンライン会議形式 ZOOM ウェビナー（LIVE）		
プログラム	時間	演題等	講演者等
	13:00-13:05	所長挨拶	早稲田大学理工学術院 教授 各務記念材料技術研究所 所長 勝藤 拓郎
	13:05-13:10	開会挨拶	早稲田大学理工学術院 准教授 オープンセミナー実行委員会 委員長 柳谷 隆彦
	13:10-13:50	移動体通信を支える SAW デバイスとその要素技術	村田製作所 中川 亮 氏
	13:50-14:30	バルク弾性波 (BAW) フィルタ向けの窒化物圧電薄膜の開発	同志社大学 高柳 真司 先生
	14:30-14:50	休憩	
	14:50-15:30	次世代情報通信端末向け高周波数弾性表面波 (SAW) フィルタの開発	山梨大学 鈴木 雅視 先生
	15:30-16:10	圧電 MEMS のための高性能圧電薄膜の開発	東北大学 吉田 慎哉 先生
	16:10-16:50	マイクロデバイスとしての原子周波数標準 ー光・圧電・集積回路ー	情報通信研究機構 原 基揚 氏
	16:50-17:00	閉会挨拶	早稲田大学理工学術院 教授 オープンセミナー実行委員会 副委員長 川田 宏之
対象	本学学生・教職員、一般（学外の方のご参加も歓迎いたします）		
定員	250 名（予定）		

参加費	無 料
申込方法	MyWaseda からの事前受付（2021 年 10 月 22 日（金）下記 HP 掲載・申込開始予定） 申込方法の詳細は、早稲田大学各務記念材料技術研究所 HP の「News」をご確認ください。 URL> https://www.waseda.jp/fsci/zaiken/news QR Code>  ※人数の把握のため、可能な限り事前申込にご協力をお願いします。
申込締切	2021 年 12 月 8 日（水） 12：00

問合せ先

早稲田大学各務記念材料技術研究所 オープンセミナー係（担当：後藤、菊池）
連絡先：03-3203-4782 メール：zaikenjimu@list.waseda.jp